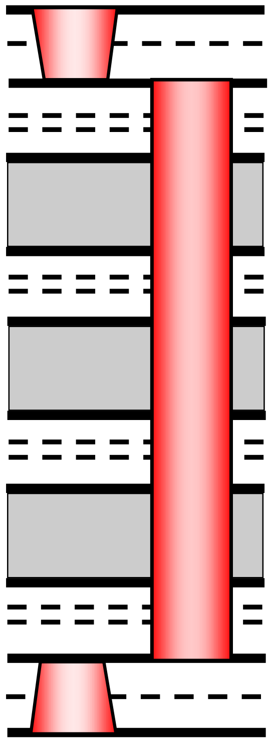
LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI10_1+8b+1_1,25_35

10 - Lagen

Kerne: 0,10 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		1 + 8B + 1
KUNDE:		

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	12 µm		35	
					2 x 1080	133	
3	2			35 µm		33	
			0,100 mm			100	
4	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
5	4			35 µm		33	
			0,100 mm			100	
6	5			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
7	6			35 µm		33	
			0,100 mm			100	
8	7			35 µm		33	
					2 x 1080	133	
9	RSK1			12 µm		35	
					1 x 1080	60	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1226

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

					Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,25**	+/-	0,11	mm		
DICKE über galv. Endoberfläche	1,34	+/-	0,14	mm		
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,40	+/-	0,16	mm		
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	Seite:	12+